材料部品部会主催の第十五回勉強会のご案内

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

来る6月14日(水曜日)に下記のテーマで材料部品部会主催の第十五回勉強会を実施いたします。

日本の電子テバイス産業を発展させる為には国内外の動向を常に把握し次世代を見据えた電子デバイスの開発が望まれるところです。今回の勉強会では、三人の講師をお招きし国内外の最新の技術動向、電子デバイス産業の今年の大躍進を中心に下記のテーマで勉強会を実施いたします。

今回の勉強会も大変貴重な機会ですので皆様多数のご参加をお待ちしております。

日時 平成29年6月14日(水) 13:00~16:30

場所 御茶ノ水めっきセンター 4 F会議室 03-3814-5621 (代) 東京都文京区湯島1-11-10 http://www.tmk.or.jp/gaiyou.html

[プログラム]

13:00~14:00

「サーバーの実装技術の推移と今後の動向」

講師 横内 貴志男 氏/元・富士通株式会社)

14:00-15:00

「技術と社会をつなぐサステナビリティ設計学」

講師 木下 祐介 氏/ 東京大学 大学院工学系研究科・工学博士

15:00-15:10 休憩

15:10-16:30

「半導体産業は、30年に一回の一大ブームがやってくる」

~100兆円マーケットが視野に入り装置/材料は狂喜乱舞の世界~

講師 泉谷 渉 氏/(株)産業タイムズ社・代表取締役社長

(注)参加希望の方は別紙回答用紙にて、6月9日までにメールでお申し込みください。 確認後メール返信いたします。

募集予定人員60名(定員を超えましたら、締め切らせていただきます)。

なお当日、配布資料代として NEDIA 会員の方は 2,000 円/人を、また非会員の方は 5,000 円/人(資料代含む)を徴収いたしますのでご承知おきください。

以上